

無残渣ペーストで、ボイドフリーも実現

Void-free soldering with residue-free paste

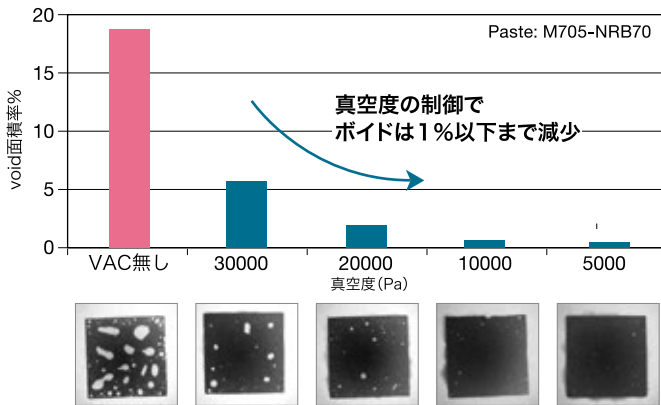
特長

- 真空リフロー炉SVR-625GTで、無残渣&ボイドフリーを実現
- 無残渣/無洗浄で高信頼性実装を実現
- 洗浄液不要で、環境負荷低減と低価格化を実現

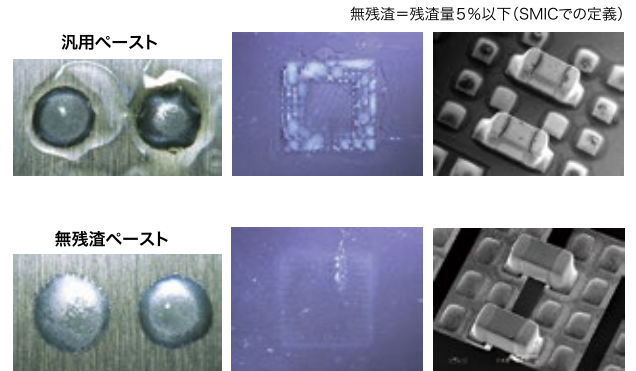


仕様

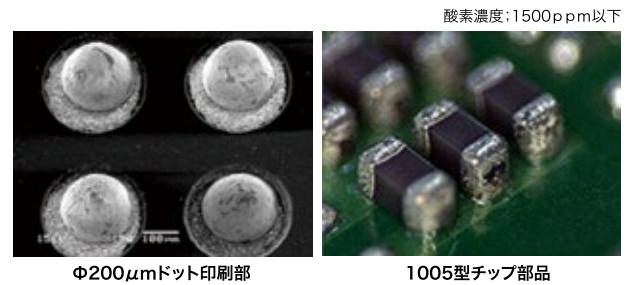
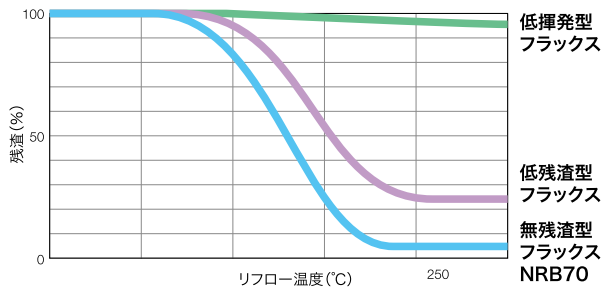
- 真空炉SVR-625GTで、パワーデバイスのボイドフリー化を実現



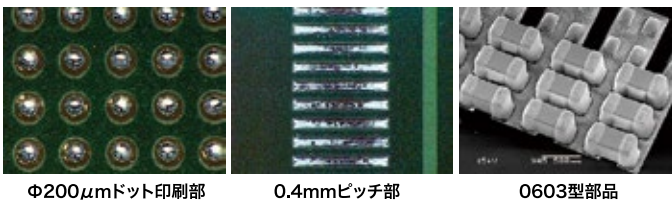
- N₂リフロー炉でも、無残渣で良好な濡れ性を実現



- 熱気化性材料の変更で、フラックス残渣5%以下を達成し、無洗浄化を実現



- Type5粉とNRB70Hで、狭ピッチ微小部品も無残渣実装



- BGA実装での、アンダーフィルの充填性を阻害せず

